

### 关键指标

频率：2~18GHz  
隔离度：20dB  
插入损耗：1.2dB  
芯片尺寸：2mm×2mm

### 产品简介

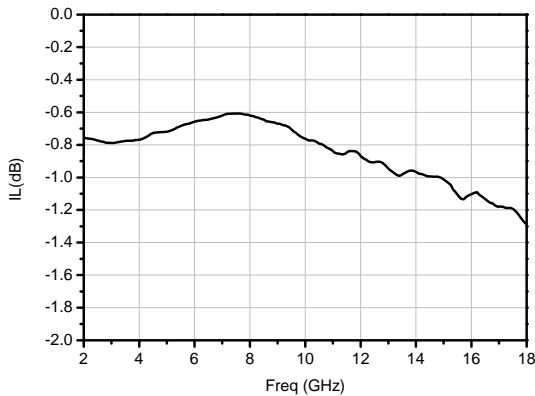
HG126G3 芯片为 2-18GHz 一分二功分器芯片，该芯片插入损耗小于 1.2dB，隔离度大于 15dB。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C)

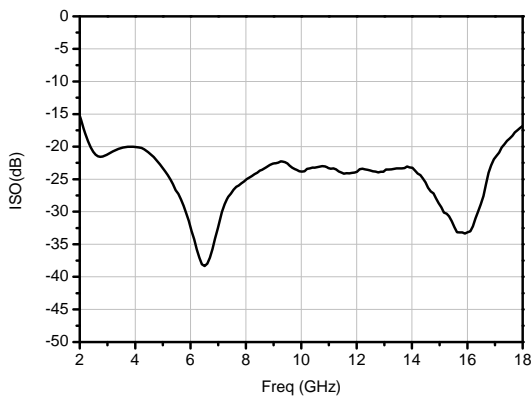
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~18		
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	1.2	-
隔离度(dB)	-	20	-

### 典型测试曲线

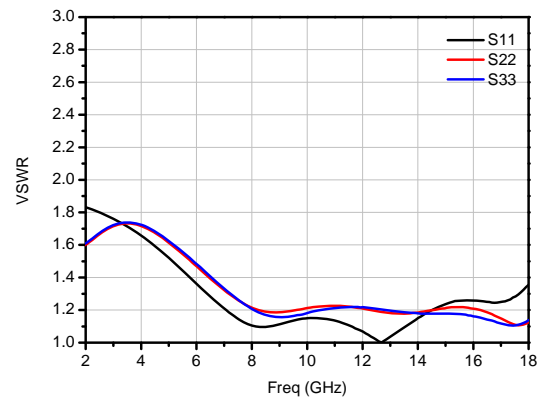
插入损耗



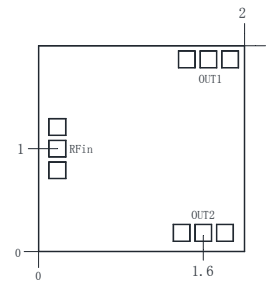
隔离度



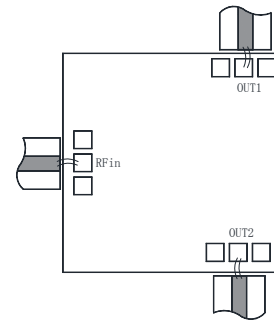
驻波



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。